

絶縁伝熱層の一般的特性(代表値)

	高耐熱・高熱 伝導タイプTH-1	汎用タイプK-1	超高熱伝導 タイプ(開発品)	高耐ハンダクラック 性タイプ(EL-1)
熱伝導率(W/m・K)	4	2	8	2.5
体積抵抗率(Ω・cm)	4.1×10^{13}	2.2×10^{13}	1.0×10^{14}	2.0×10^{15}
熱膨張率(%)	6.7×10^{-5}	7.8×10^{-5}	測定中	6.1×10^{-5}
ヤング率(N/m ²)	5.4×10^9	5.1×10^9	測定中	3.0×10^9
ポアソン比	0.34	0.3	測定中	0.32
ガラス転移点(℃)	165	104	165(推定)	50

標準仕様

		材質	種類	備考
1	ベース金属板	アルミニウム(1050)	1.0,1.5,2.0mm	
		アルミニウム(5052)	3.0mm	
2	絶縁伝熱層	無機フィラー高充填 エポキシ樹脂系	Zタイプ	低耐電圧用(AC2kV)
			Yタイプ	中耐電圧用(AC3kV)
			Xタイプ	高耐電圧用(AC5kV)
3	1.銅回路	銅箔 〔 Niメッキ Ni-Auメッキ 可〕	35 μm	一般回路用
			70 μm	大電流回路用
			105 μm	大電流回路用
	2.アルミパッド付 銅回路	アルミ/銅接合箔	Al 40 μm/Cu10 μm	ワイヤーボンディング用 (ベアチップ搭載)
			Al 40 μm/Cu85 μm	大電流回路用
4	半田レジスト	エポキシ系樹脂他	5 ~ 30 μm	